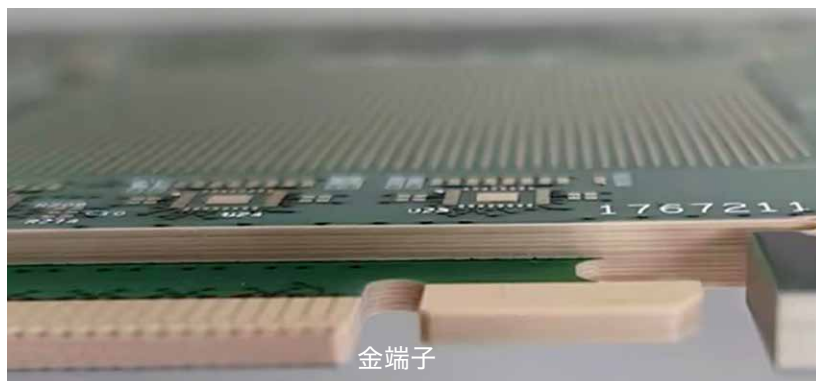
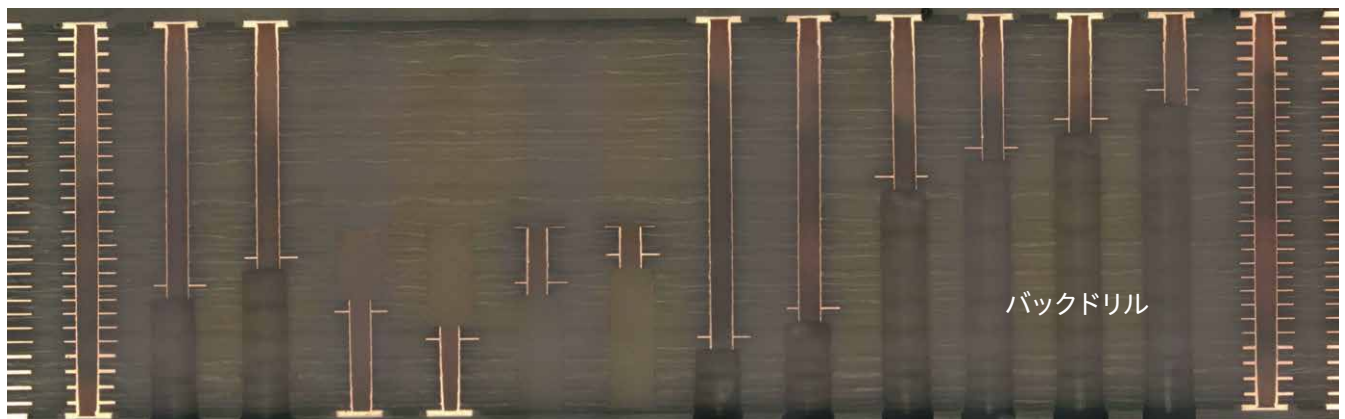


AIサーバー対応高密度多層基板

28層+Backdrill+複合板厚端子金対応

特長 Features

- バックドリルによるビアスタブ除去により信号特性向上
- 1枚の基板内での板厚制御によりPCI-e規格の金端子に対応
- 各種高周波材料に対応



設計仕様

材料型番	EM-890K
層構成	28L (14L+14L)
板厚 (mm)	3.424mm
L/S (μm)	95/76
TH/Pad (mm)	0.2/0.4825
THアスペクト比	17
表面処理	電解金+無電解金

層構成

層番号	材料	厚さ (mm)
1	銅	0.035
2	FR4	0.127
3	銅	0.035
4	FR4	0.127
5	銅	0.035
6	FR4	0.127
7	銅	0.035
8	FR4	0.127
9	銅	0.035
10	FR4	0.127
11	銅	0.035
12	FR4	0.127
13	銅	0.035
14	FR4	0.127
15	銅	0.035
16	FR4	0.127
17	銅	0.035
18	FR4	0.127
19	銅	0.035
20	FR4	0.127
21	銅	0.035
22	FR4	0.127
23	銅	0.035
24	FR4	0.127
25	銅	0.035
26	FR4	0.127
27	銅	0.035
28	銅	0.035

